|  |
| --- |
| [2023-2029年中国IC制造行业现状调研及前景趋势预测报告](https://www.20087.com/7/51/ICZhiZaoDeQianJingQuShi.html) |



#### [中国市场调研网](https://www.20087.com/)

[www.20087.com](https://www.20087.com/)

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名称： | [2023-2029年中国IC制造行业现状调研及前景趋势预测报告](https://www.20087.com/7/51/ICZhiZaoDeQianJingQuShi.html) |
| 报告编号： | 3055517　　←电话咨询时，请说明该编号。 |
| 市场价： | 电子版：9200 元　　纸介＋电子版：9500 元 |
| 优惠价： | 电子版：8200 元　　纸介＋电子版：8500 元　　可提供增值税专用发票 |
| 咨询电话： | 400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099 |
| Email： | Kf@20087.com |
| 在线阅读： | [<https://www.20087.com/7/51/ICZhiZaoDeQianJingQuShi.html>](https://www.20087.com/2/95/ZhiNengXiWanJiShiChangQianJingYuCe.html) |
| 温馨提示： | 订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。 |

二、内容简介

　　IC（集成电路）制造是现代电子工业的基础，随着5G、物联网、人工智能等技术的发展，对高性能IC的需求日益增长。目前，IC制造技术不断进步，尤其是纳米级工艺节点的突破，使得芯片的集成度和性能大幅提升。此外，随着材料科学的进步，新型材料的应用使得IC的制造工艺更加多样化。同时，随着市场需求的变化，IC制造也更加注重定制化和专业化，以满足不同领域的需求。  
　　未来，IC制造的发展将更加注重技术创新和应用领域的拓展。一方面，随着摩尔定律逼近物理极限，IC制造将更加关注新材料和新架构的研究，以继续提高芯片的性能和能效。另一方面，随着物联网和智能设备的普及，IC制造将更加注重芯片的低功耗和安全性。此外，随着定制化芯片需求的增长，IC制造将更加注重灵活生产模式，以更快的速度响应市场变化。  
　　《[2023-2029年中国IC制造行业现状调研及前景趋势预测报告](https://www.20087.com/7/51/ICZhiZaoDeQianJingQuShi.html)》全面分析了我国IC制造行业的现状、市场需求、市场规模以及价格动态，探讨了IC制造产业链的结构与发展。IC制造报告对IC制造细分市场进行了剖析，同时基于科学数据，对IC制造市场前景及发展趋势进行了预测。报告还聚焦IC制造重点企业，并对其品牌影响力、市场竞争力以及行业集中度进行了评估。IC制造报告为投资者、产业链相关企业及政府决策部门提供了专业、客观的参考，是了解和把握IC制造行业发展动向的重要工具。  
  
第一章 IC行业介绍  
　　1.1 IC相关组成部分  
　　　　1.1.1 存储器  
　　　　1.1.2 逻辑电路  
　　　　1.1.3 微处理器  
　　　　1.1.4 模拟电路  
　　1.2 IC制造工艺  
　　　　1.2.1 热处理工艺  
　　　　1.2.2 光刻工艺  
　　　　1.2.3 刻蚀工艺  
　　　　1.2.4 离子注入工艺  
　　　　1.2.5 薄膜沉积工艺  
　　　　1.2.6 清洗  
　　1.3 IC行业产业链结构  
　　　　1.3.1 上游设计环节  
　　　　1.3.2 中游制造环节  
　　　　1.3.3 下游封测环节  
　　1.4 IC相关制造模式  
　　　　1.4.1 IDM模式  
　　　　1.4.2 Foundry模式  
　　　　1.4.3 Chipless模式  
  
第二章 2018-2023年全球IC制造行业运行情况  
　　2.1 全球IC制造业发展概况  
　　　　2.1.1 IC制造市场运行现状  
　　　　2.1.2 全球IC制造竞争格局  
　　　　2.1.3 全球IC制造工艺发展  
　　　　2.1.4 全球IC制造企业发展  
　　　　2.1.5 IC制造企业发展态势  
　　2.2 全球IC制造业技术专利  
　　　　2.2.1 全球申请趋势分析  
　　　　2.2.2 优先权的国家分析  
　　　　2.2.3 主要的申请人分析  
　　　　2.2.4 技全球术态势分析  
　　2.3 全球集成电路产业园区  
　　　　2.3.1 美国  
　　　　2.3.2 日本  
　　　　2.3.3 欧洲  
　　　　2.3.4 亚太  
  
第三章 2018-2023年中国IC制造发展环境分析  
　　3.1 经济环境  
　　　　3.1.1 全球宏观经济  
　　　　3.1.2 国内宏观经济  
　　　　3.1.3 工业和建筑业  
　　　　3.1.4 宏观经济展望  
　　3.2 社会环境  
　　　　3.2.1 人口结构分析  
　　　　3.2.2 居民收入水平  
　　　　3.2.3 居民消费水平  
　　　　3.2.4 工业企业利润  
　　3.3 投资环境  
　　　　3.3.1 固定资产投资  
　　　　3.3.2 社会融资规模  
　　　　3.3.3 财政收支安排  
　　　　3.3.4 地方投资计划  
  
第四章 2018-2023年中国IC制造政策环境分析  
　　4.1 国家政策解读  
　　　　4.1.1 促进集成电路产业高质量发展发政策  
　　　　4.1.2 促进集成电路产业高质量发展所得税  
　　　　4.1.3 促进制造业产品和服务质量提升意见  
　　　　4.1.4 工业和通信业职业技能提升行动计划  
　　　　4.1.5 制造业设计能力提升专项行动计划  
　　4.2 IC行业相关标准分析  
　　　　4.2.1 IC标准组织  
　　　　4.2.2 IC国家标准  
　　　　4.2.3 行业IC标准  
　　　　4.2.4 团体IC标准  
　　　　4.2.5 IC标准现状  
　　4.3 “十四五”IC产业政策  
　　　　4.3.1 注重工艺制造人才的引进  
　　　　4.3.2 半导体投资不宜盲目跟风  
　　　　4.3.3 加大关键设备国产化支持  
  
第五章 2018-2023年中国IC制造行业运行情况  
　　5.1 中国IC制造业整体发展概况  
　　　　5.1.1 IC制造业产业背景  
　　　　5.1.2 IC制造业发展规律  
　　　　5.1.3 IC制造业相关特点  
　　　　5.1.4 IC制造业发展逻辑  
　　5.2 中国IC制造业发展现状分析  
　　　　5.2.1 IC制造业发展现状  
　　　　5.2.2 IC制造业销售规模  
　　　　5.2.3 IC制造业市场占比  
　　　　5.2.4 IC制造业未来增量  
　　　　5.2.5 IC制造业水平对比  
　　5.3 中国台湾IC制造行业运行分析  
　　　　5.3.1 中国台湾IC制造发展历程  
　　　　5.3.2 中国台湾IC产业全球份额  
　　　　5.3.3 中国台湾IC产值具体分布  
　　　　5.3.4 中国台湾重点IC公司营收  
　　　　5.3.5 中国台湾IC产值未来预测  
　　5.4 2018-2023年中国IC进出口数据分析  
　　　　5.4.1 进出口总量数据分析  
　　　　5.4.2 主要贸易国进出口情况分析  
　　　　5.4.3 主要省市进出口情况分析  
　　5.5 IC制造业面临的问题与挑战  
　　　　5.5.1 IC制造业面临问题  
　　　　5.5.2 IC制造业生态问题  
　　　　5.5.3 IC制造业发展挑战  
　　5.6 IC制造业发展的对策与建议  
　　　　5.6.1 IC制造业发展策略  
　　　　5.6.2 IC制造业生态对策  
　　　　5.6.3 IC制造业政策建议  
  
第六章 IC制造产业链介绍  
　　　　6.1.1 IC制造产业链整体介绍  
　　　　6.1.2 上游——原料和设备  
　　　　6.1.3 中游——制造和封装  
　　　　6.1.4 下游——应用市场  
　　6.2 设计市场发展现状分析  
　　　　6.2.1 IC设计企业整体运行  
　　　　6.2.2 IC设计市场规模分析  
　　　　6.2.3 IC设计公司数量变化  
　　　　6.2.4 IC设计市场存在问题  
　　　　6.2.5 IC设计行业机遇分析  
　　6.3 封装市场发展现状分析  
　　　　6.3.1 封装市场简单概述  
　　　　6.3.2 半导体的封装市场  
　　　　6.3.3 先进封装市场运行  
　　　　6.3.4 封装市场发展方向  
　　6.4 测试市场发展现状分析  
　　　　6.4.1 IC测试内容  
　　　　6.4.2 IC测试规模  
　　　　6.4.3 IC测试厂商  
　　　　6.4.4 IC测试趋势  
  
第七章 2018-2023年IC制造相关材料市场分析  
　　7.1 IC材料市场整体运行分析  
　　　　7.1.1 IC材料市场发展现状  
　　　　7.1.2 IC材料市场发展思路  
　　　　7.1.3 IC材料产业现存问题  
　　　　7.1.4 IC材料市场发展目标  
　　　　7.1.5 IC材料产业发展展望  
　　7.2 硅片材料  
　　　　7.2.1 硅片制造工艺  
　　　　7.2.2 硅片制造方法  
　　　　7.2.3 市场运行情况  
　　　　7.2.4 硅片产业机遇  
　　　　7.2.5 硅片产业挑战  
　　7.3 光刻材料  
　　　　7.3.1 光刻材料的组成  
　　　　7.3.2 光刻胶整体市场  
　　　　7.3.3 光刻胶市场竞争  
　　　　7.3.4 光刻胶产业特点  
　　　　7.3.5 光刻胶产业问题  
　　　　7.3.6 光刻胶提升方面  
　　　　7.3.7 光刻胶发展建议  
　　7.4 抛光材料  
　　　　7.4.1 主要的材料介绍  
　　　　7.4.2 光刻胶发展历程  
　　　　7.4.3 光刻胶发展现状  
　　　　7.4.4 产品相关的企业  
　　7.5 其他材料市场分析  
　　　　7.5.1 掩模版  
　　　　7.5.2 湿化学品  
　　　　7.5.3 电子气体  
　　　　7.5.4 靶材及蒸发材料  
　　7.6 材料市场重大工程建设  
　　　　7.6.1 IC关键材料及装备自主可控工程  
　　　　7.6.2 相关材料、工艺及装备验证平台  
　　　　7.6.3 先进半导体材料在终端领域应用  
　　7.7 材料市场发展对策建议  
　　　　7.7.1 抓住战略发展机遇期  
　　　　7.7.2 布局下一代的IC技术  
　　　　7.7.3 构建产业技术创新链  
  
第八章 2018-2023年IC制造环节设备市场分析  
　　8.1 半导体设备  
　　　　8.1.1 半导体设备市场规模  
　　　　8.1.2 半导体设备国产化率  
　　　　8.1.3 半导体设备政策支持  
　　　　8.1.4 半导体设备市场格局  
　　　　8.1.5 半导体设备主要产商  
　　　　8.1.6 半导体设备投资占比  
　　　　8.1.7 半导体设备规模预测  
　　8.2 晶圆制造设备  
　　　　8.2.1 晶圆制造设备主要类型  
　　　　8.2.2 晶圆制造设备市场规模  
　　　　8.2.3 制造设备市场份额分析  
　　　　8.2.4 晶圆制造设备投资占比  
　　　　8.2.5 晶圆制造设备规模预测  
　　8.3 光刻机设备  
　　　　8.3.1 光刻机发展历程  
　　　　8.3.2 光刻机的产业链  
　　　　8.3.3 光刻机市场供应  
　　　　8.3.4 光刻机设备占比  
　　　　8.3.5 全球光刻机销量  
　　8.4 刻蚀机设备  
　　　　8.4.1 刻蚀机的主要分类  
　　　　8.4.2 刻蚀机的市场规模  
　　　　8.4.3 刻蚀机市场集中度  
　　　　8.4.4 刻蚀机的国产替代  
　　　　8.4.5 刻蚀机的规模预测  
　　8.5 硅片制造设备  
　　　　8.5.1 制造设备简介  
　　　　8.5.2 市场厂商分布  
　　　　8.5.3 主要设备涉及  
　　　　8.5.4 设备市场规模  
　　　　8.5.5 设备市场项目  
　　8.6 检测设备  
　　　　8.6.1 检测设备主要分类  
　　　　8.6.2 检测设备市场占比  
　　　　8.6.3 检测设备市场格局  
　　　　8.6.4 工艺检测设备分析  
　　　　8.6.5 晶圆检测设备分析  
　　　　8.6.6 FT测试设备分析  
　　8.7 中国IC设备企业  
　　　　8.7.1 屹唐半导体科技有限公司  
　　　　8.7.2 中国电子科技集团有限公司  
　　　　8.7.3 盛美半导体设备股份有限公司  
　　　　8.7.4 北方华创科技集团股份有限公司  
  
第九章 2018-2023年晶圆制造厂具体市场分析  
　　9.1 晶圆制造厂市场运行分析  
　　　　9.1.1 全球晶圆制造产能  
　　　　9.1.2 全球晶圆制造产量  
　　　　9.1.3 中国晶圆厂的建设  
　　　　9.1.4 晶圆厂的市场招标  
　　　　9.1.5 晶圆制造产能预测  
　　9.2 晶圆代工厂市场运行分析  
　　　　9.2.1 全球晶圆代工市场  
　　　　9.2.2 全球晶圆代工工厂  
　　　　9.2.3 中国晶圆代工市场  
　　　　9.2.4 中国晶圆代工工厂  
　　9.3 中国晶圆厂生产线分布  
　　　　9.3.1 12英寸（300mm）晶圆生产线  
　　　　9.3.2 8英寸（200mm）晶圆生产线  
　　　　9.3.3 6英寸及以下尺寸晶圆生产线  
　　　　9.3.4 化合物半导体晶圆生产线  
　　9.4 晶圆厂建设市场机遇  
　　　　9.4.1 供给端来看  
　　　　9.4.2 需求端来看  
  
第十章 2018-2023年IC制造相关技术分析  
　　10.1 IC制造技术指标  
　　　　10.1.1 集成度  
　　　　10.1.2 特征尺寸  
　　　　10.1.3 晶片直径  
　　　　10.1.4 封装  
　　10.2 化学机械抛光CMP  
　　　　10.2.1 化学机械研磨CMP  
　　　　10.2.2 CMP国产化现状  
　　　　10.2.3 CMP国产化协作  
　　10.3 光刻技术  
　　　　10.3.1 光刻技术耗时  
　　　　10.3.2 光刻技术内涵  
　　　　10.3.3 光刻技术工艺  
　　10.4 刻蚀技术  
　　　　10.4.1 刻蚀技术简介  
　　　　10.4.2 主流刻蚀技术  
　　　　10.4.3 刻蚀技术壁垒  
　　10.5 IC技术发展趋势  
　　　　10.5.1 尺寸逐渐变小  
　　　　10.5.2 新技术和材料  
　　　　10.5.3 新领域的运用  
  
第十一章 2018-2023年IC制造行业建设项目分析  
　　11.1 研发及产业化建设项目  
　　　　11.1.1 项目概况  
　　　　11.1.2 项目必要性分析  
　　　　11.1.3 项目可行性分析  
　　　　11.1.4 项目投资概算  
　　11.2 芯片测试产能建设项目  
　　　　11.2.1 项目概况  
　　　　11.2.2 项目必要性分析  
　　　　11.2.3 项目可行性分析  
　　　　11.2.4 项目投资概算  
　　11.3 存储先进封测与模组制造项目  
　　　　11.3.1 项目基本情况  
　　　　11.3.2 项目必要性分析  
　　　　11.3.3 项目可行性分析  
　　　　11.3.4 项目投资概算  
　　11.4 晶圆制程保护膜产业化建设项目  
　　　　11.4.1 项目必要性分析  
　　　　11.4.2 项目投资概算  
　　　　11.4.3 项目周期进度  
　　　　11.4.4 审批备案情况  
　　11.5 8英寸MEMS国际代工线建设项目  
　　　　11.5.1 项目基本情况  
　　　　11.5.2 项目必要性分析  
　　　　11.5.3 项目可行性分析  
　　　　11.5.4 项目投资概算  
　　　　11.5.5 项目经济效益  
  
第十二章 国外IC制造重点企业介绍  
　　12.1 英特尔股份有限公司  
　　　　12.1.1 企业发展概况  
　　　　12.1.2 企业经营状况分析  
　　12.2 三星电子  
　　　　12.2.1 企业发展概况  
　　　　12.2.2 企业经营状况分析  
　　12.3 德州仪器  
　　　　12.3.1 企业发展概况  
　　　　12.3.2 企业经营状况分析  
　　12.4 海力士半导体公司  
　　　　12.4.1 企业发展概况  
　　　　12.4.2 企业经营状况分析  
　　12.5 安森美半导体  
　　　　12.5.1 企业发展概况  
　　　　12.5.2 企业经营状况分析  
  
第十三章 国内IC制造重点企业介绍  
　　13.1 中国台湾积体电路制造公司  
　　　　13.1.1 企业发展概况  
　　　　13.1.2 经营效益分析  
　　　　13.1.3 业务经营分析  
　　　　13.1.4 财务状况分析  
　　　　13.1.5 核心竞争力分析  
　　　　13.1.6 公司发展战略  
　　13.2 华润微电子有限公司  
　　　　13.2.1 企业发展概况  
　　　　13.2.2 经营效益分析  
　　　　13.2.3 业务经营分析  
　　　　13.2.4 财务状况分析  
　　　　13.2.5 核心竞争力分析  
　　　　13.2.6 公司发展战略  
　　13.3 芯源微电子设备股份有限公司  
　　　　13.3.1 企业发展概况  
　　　　13.3.2 经营效益分析  
　　　　13.3.3 业务经营分析  
　　　　13.3.4 财务状况分析  
　　　　13.3.5 核心竞争力分析  
　　　　13.3.6 公司发展战略  
　　13.4 中芯国际集成电路制造有限公司  
　　　　13.4.1 企业发展概况  
　　　　13.4.2 经营效益分析  
　　　　13.4.3 业务经营分析  
　　　　13.4.4 财务状况分析  
　　　　13.4.5 核心竞争力分析  
　　　　13.4.6 公司发展战略  
　　13.5 闻泰科技股份有限公司  
　　　　13.5.1 企业发展概况  
　　　　13.5.2 经营效益分析  
　　　　13.5.3 业务经营分析  
　　　　13.5.4 财务状况分析  
　　　　13.5.5 核心竞争力分析  
　　　　13.5.6 公司发展战略  
  
第十四章 2018-2023年IC制造业的投资市场分析  
　　14.1 IC产业投资分析  
　　　　14.1.1 IC产业投资基金  
　　　　14.1.2 IC产业投资机会  
　　　　14.1.3 IC产业投资问题  
　　　　14.1.4 IC产业投资思考  
　　14.2 IC投资基金介绍  
　　　　14.2.1 IC投资资金来源  
　　　　14.2.2 IC投资具体项目  
　　　　14.2.3 IC投资金额情况  
　　　　14.2.4 IC投资基金营收  
　　14.3 IC制造投资分析  
　　　　14.3.1 投资的整体市场  
　　　　14.3.2 IC制造投资市场  
　　　　14.3.3 IC制造投资项目  
  
第十五章 中.智.林.：2023-2029年IC制造行业趋势分析  
　　15.1 IC制造业发展的目标与机遇  
　　　　15.1.1 IC制造业发展目标  
　　　　15.1.2 IC制造业发展趋势  
　　　　15.1.3 IC制造业崛起机遇  
　　　　15.1.4 IC制造业发展机遇  
　　15.2 2023-2029年中国IC制造业预测分析  
　　　　15.2.1 2023-2029年中国IC制造业影响因素分析  
　　　　15.2.2 2023-2029年中国IC制造业规模预测  
  
图表目录  
　　图表 IC制造行业历程  
　　图表 IC制造行业生命周期  
　　图表 IC制造行业产业链分析  
　　……  
　　图表 2018-2023年IC制造行业市场容量统计  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业市场规模及增长情况  
　　……  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业销售收入分析 单位：亿元  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业盈利情况 单位：亿元  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业利润总额分析 单位：亿元  
　　……  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业企业数量情况 单位：家  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业企业平均规模情况 单位：万元/家  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业竞争力分析  
　　……  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业盈利能力分析  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业运营能力分析  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业偿债能力分析  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业发展能力分析  
　　图表 2018-2023年中国IC制造行业经营效益分析  
　　……  
　　图表 \*\*地区IC制造市场规模及增长情况  
　　图表 \*\*地区IC制造行业市场需求情况  
　　图表 \*\*地区IC制造市场规模及增长情况  
　　图表 \*\*地区IC制造行业市场需求情况  
　　图表 \*\*地区IC制造市场规模及增长情况  
　　图表 \*\*地区IC制造行业市场需求情况  
　　……  
　　图表 IC制造重点企业（一）基本信息  
　　图表 IC制造重点企业（一）经营情况分析  
　　图表 IC制造重点企业（一）盈利能力情况  
　　图表 IC制造重点企业（一）偿债能力情况  
　　图表 IC制造重点企业（一）运营能力情况  
　　图表 IC制造重点企业（一）成长能力情况  
　　图表 IC制造重点企业（二）基本信息  
　　图表 IC制造重点企业（二）经营情况分析  
　　图表 IC制造重点企业（二）盈利能力情况  
　　图表 IC制造重点企业（二）偿债能力情况  
　　图表 IC制造重点企业（二）运营能力情况  
　　图表 IC制造重点企业（二）成长能力情况  
　　……  
　　图表 2023-2029年中国IC制造行业市场容量预测  
　　图表 2023-2029年中国IC制造行业市场规模预测  
　　图表 2023-2029年中国IC制造市场前景分析  
　　图表 2023-2029年中国IC制造行业发展趋势预测  
略……

了解《[2023-2029年中国IC制造行业现状调研及前景趋势预测报告](https://www.20087.com/7/51/ICZhiZaoDeQianJingQuShi.html)》，报告编号：3055517，

请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，

Email邮箱：[Kf@20087.com](mailto:Kf@20087.com)

详细介绍：<https://www.20087.com/7/51/ICZhiZaoDeQianJingQuShi.html>

了解更多，请访问上述链接，以下无内容！